

レーザー協会第 181 回研究会 レーザー加工機と加工・診断技術

【日時】 2018 年 5 月 23 日(水) 14:30～17:00

【会場】 中央大学 後楽園キャンパス 6 号館 3 階 6325 号室
〒112-8551 東京都文京区春日 1-13-27
<http://www.chuo-u.ac.jp/access/kourakuen/>

【プログラム】

14:30～13:35 開会挨拶

レーザー協会会長

14:35～15:15 「板金業界における最新レーザー事情

—ファイバーレーザー加工機の普及が加速—

マシニスト出版(株) 石川 紀夫 氏

15:15～15:55 「本焼結ジルコニアセラミックスのレーザー援用切削加工」

東京大学 木崎 通 氏

15:55～16:15 休憩

16:15～16:55 「レーザー溶接のモニタリングに関する最新技術と製品紹介」

プレシテック・ジャパン(株) 牛山 直幸 氏

16:55～17:00 閉会挨拶

【参加費】 会員:無料, 非会員:4,000 円 (当日お支払いください)

【申し込み先】 会員の方は別途お送りする案内にある返信票に記入のうえレーザー協会事務局へメールでご送付ください。非会員の方はレーザー協会ウェブページ <http://jslt.jp/> の申し込みフォームよりお申し込みください。

【問合せ先】 レーザー協会事務局 laser@mech.saitama-u.ac.jp